

# SiCウェーハ粗研削用メタルボンドホイール セミドーザー

平面研削  
バックグラインド

高硬度のSiCウェーハにおいて高能率と長寿命を両立可能なメタルボンドホイールです

## 特長

### ■ 高能率

新開発した**特殊ボンド採用**により、  
切屑の排出性向上や高い砥粒切込を実現できるため、  
研削能率が向上し**安定した切れ味**が持続します

### ■ 長寿命

砥粒保持力の強い**メタルボンド**を適応することで、ボンド後退を少なく抑え、  
砥粒を効率的に作用させることできるため、**長寿命化**が可能となります



## 効果

### ■ 生産性向上と加工コスト低減

高能率でも安定した切れ味が持続するため、生産性の向上に貢献します  
また、長寿命工具であるため、摩耗率を抑えることで加工コスト低減に貢献します

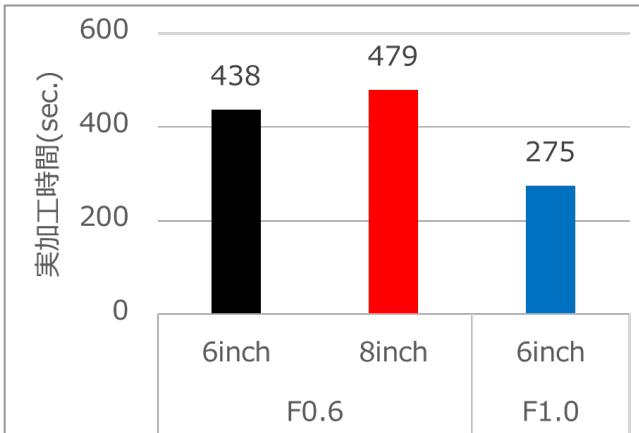
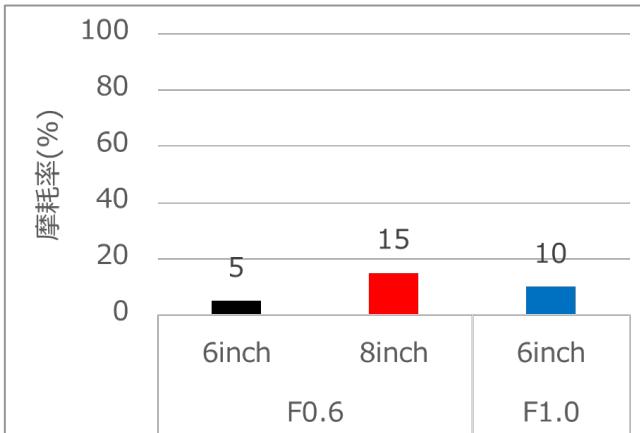
## 評価事例

### 【加工条件】

ワーク	6inch SiCウェーハ, 8inch SiCウェーハ	
送り速度	0.6 $\mu$ m/sec., 1.0 $\mu$ m/sec.	
取り代	250 $\mu$ m	
ホイール回転数	2600 rpm	ウェーハ回転数 300 rpm

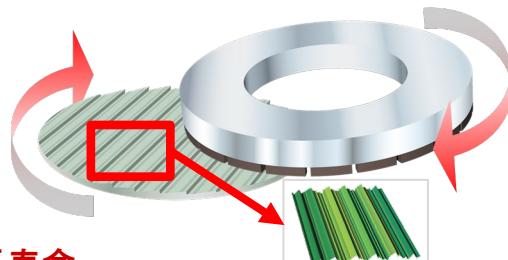
### 摩耗率

### 実加工時間(取り代250 $\mu$ m)



## 特長

## ■レーザー剥離ウェーハの平面研削・BGにおいても長寿命と高能率が両立可能です



## ■ 長寿命

レーザー剥離ウェーハ特有の面状態に適応した専用ボンドにより耐摩耗性が向上し摩耗率を大幅に低減可能です。

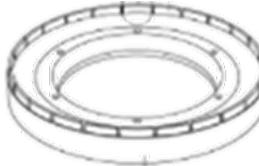
## ■ 高能率

砥粒の目替わり性をレーザー剥離ウェーハに最適化することで、切り込み性能が向上し高能率加工を実現します。

## ■ 摩耗率指数



## 製造範囲

砥粒	SD		
粒度	1000, 1500, 2000, 2500, 3000番		
結合度	K ~ M		
寸法	ホイール外径 D(mm)	砥材層幅 W(mm)	砥材層厚み T(mm)
	200~300	3~4	5~7
形状	カップホイール		

表記外の寸法、スペックについてはご相談ください。

## 適用用途

## ●半導体用高硬度脆性材料

ワーク材質 : SiC

加工方式 : 平面研削、バックグラインド



## ノリタケ株式会社

## 工業機材事業本部

[本社]

〒451-8501 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

TEL: 052-561-9817 FAX: 052-561-9759

E-mail: grinding@noritake.com

[https://www.noritake.co.jp/](http://www.noritake.co.jp/)

\* 本カタログに掲載の内容は予告無く変更する場合がありますので御了承ください。